

2024日本电子产品制造设备及部件技术博览会NEPCON JAPAN

产品名称	2024日本电子产品制造设备及部件技术博览会NEPCON JAPAN
公司名称	苏州京成展览有限公司
价格	99.00/件
规格参数	日本展会:2024
公司地址	苏州市花桥镇绿地杰作大厦9号楼1911室
联系电话	18913292209 18913292209

产品详情

2024日本电子科技博览会NEPCON JAPAN

【基本信息】

展会时间：2024年1月24-26日东京Big Sight 展览馆

展会时间：2023年9月13-15日；日本千叶幕张展览馆

展会规模：约1200家参展商；参观人数：约50000名；

主办单位：励展博览集团日本株式会社

组展单位：上海贸升展览服务有限公司--日本展会服务商

展会介绍

亚洲领先电子研发，制造与封装技术展会，作为“电子研发，制造与封装技术”的综合展会，NEPCON JAPAN随着日本及亚洲电子行业的发展不断成长壮大，至今已走过30多个年头。展会由电子产品制造设备及部件技术展，电子零部件检测设备及开发技术展，电子零部件封装设备及开发技术展，印刷电路展，电子元件及材料展，精密加工技术展这6个专业展会组成。是名副其实的“代表亚洲电子产业”的综合性展览会。NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”最新技术的绝佳场所而备受业界瞩目，吸引越来越多来自全球的参展商与观展人士汇聚一堂！

构成展会

NEPCON JAPAN日本电子科技博览会由六大专业展会组成：

1、电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN

汇集了各种电子产品制造及SMT所用设备、解决方案、技术及服务。

2、电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：

亚洲领先的电子研发制造领域有关测试，检查，测量和分析技术的专业展会。

3、电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXP

亚洲领先的集成电路制造展！汇集了各种先进的设备、材料及服务。

4、电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO

亚洲领先！汇集各种电子元件和材料

5、印刷电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo

装配设备、保证材料/组件、IC封装汇集了如PCB材料，设计开发委托服务与设计工具软件等各种PCBs/PWBs及技术。

6、精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO

电子制造领域精密加工技术专门展！诸如模具制造、切削、冲压加工、蚀刻等各种精密·微细加工技术汇聚一堂！

展览范围

1、电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN：贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备

2、电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务

3、电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXPO：装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

4、电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO：接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料

5、印刷电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo：装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

6、精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO:冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、模塑、难切削材料加工

【参展流程】

- 1.预定展位:确定展会展位并支付款项。
- 2.准备样品:准备需要展会现场需要展出的样品。
- 3.展品物流:通常展前2个月截止物流，选择海运居多。
- 4.人员签证:根据不同国家的出签时间，迟展前一个月申请签证。
- 5.预定行程:预定机piao酒店等商务服务,也可向去展网直接预定全包境外服务。
- 6.出发参展:乘坐国际航班前往参展城市参展